

# 臺美半導體研發聯盟簽署MOU

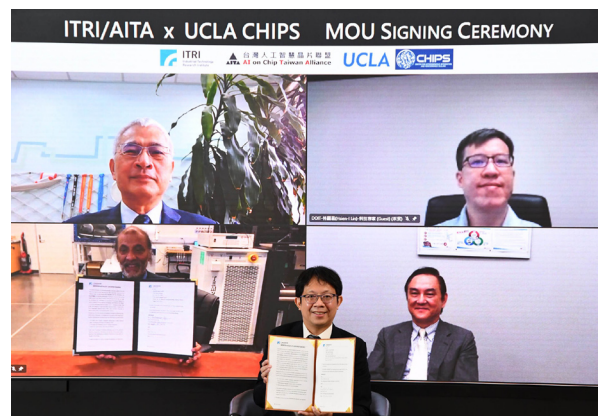
臺美雙方頂尖半導體研發聯盟於日前簽訂「異質整合先進封裝合作備忘錄」，有了臺灣成熟的產業鏈及晶片生產豐沛經驗，結合UCLA豐富的全球整合資源，將強化雙方在前瞻半導體技術研發，為布局AI晶片商機增助益。

整理／編輯部

AI晶片（AI on Chip）是AIoT應用發展的關鍵核心，早已是各國競相發展的技術重點。早在多年前，經濟部技術處便推動國內半導體與系統業者發展AI晶片的垂直整合應用；現在更支持工研院與臺美雙方具代表性的半導體研發聯盟－臺灣人工智慧晶片聯盟（AITA）及美國加州大學洛杉磯分校異質整合效能擴展中心（UCLA CHIPS）攜手合作，簽署「異質整合先進封裝合作備忘錄」，將加深臺美供應鏈合作，搶攻AI人工智慧晶片新商機。

經濟部技術處科技專家林顯易表示，臺灣擁有完整的半導體產業鏈與AIoT優勢，美國則在高效能運算上具有不可取代的地位，長期以來合作緊密。為深化雙方產業合作關係，技術處支持工研院、AITA與UCLA CHIPS攜手合作，從設計、製造、封裝領域迅速掌握國際系統規格趨勢，再結合臺灣半導體先進製造，投入高效能運算AI晶片開發。「雙方優勢互補，將打造出下世代AI創新技術與新服務！」

AITA聯盟會長、同時也是鈺創科技董事長盧超群也表示，AITA聯盟串連國內半導體相關產、官、學資源，共同搭建AI生態系並發展關鍵技術，會員數已超過125家；盟內已有多家美商會員，在AITA所建立的平台已進行頻繁的半導體技術交流合作。本次與UCLA CHIPS的合作，將加深異質整合國際規格及技術發聲與交流，將為臺灣業者搶先進行AI晶片战略布局先機，加速AI晶片發展。



在經濟部技術處科技專家林顯易（右上）與工研院副院長張培仁（左上）的見證下，由工研院電光系統所所長吳志毅（中）與美國加州大學洛杉磯分校教授Subramanian S. Iyer（左下）簽署「異質整合先進封裝合作備忘錄」。

工研院電子與光電系統研究所所長吳志毅指出，此次結盟不僅可以向國際宣傳臺灣AI晶片間傳輸技術，讓臺灣版晶片間高速傳輸共通介面推廣至國際；加上UCLA CHIPS擁有最新的技術資訊，透過結盟可將國外先進系統需求串接國內生態系，同時整合AITA及國內半導體上下游能量。「初期可在工研院少量試產線中進行雛型樣品的功能驗證，未來銜接到國內半導體產業鏈接單生產，進一步協助產業界接軌國際。」

美國加州大學洛杉磯分校教授Subramanian S. Iyer也表示，UCLA CHIPS著眼於工研院的創新技術與豐富的經驗，「未來將持續與工研院，在高效能運算、AI異質整合與封裝技術領域上進行密切合作。」相信這對未來的研究方向、技術開發與人才交流等層面，都會產生深刻的影響。■